実装フェスタ関西 2021 オンライン開催 のご案内

リアル開催の魅力をそのまま『オンライン開催』に盛り込みました!!

日時： 2021 年 12/13（月）12:30 ～ 12/14（火）17:20

リアルと同様、分野を超えた技術者間の交流の場を重視。
各業界における著名な先生方を基調講演や招待講演にお越し頂きます。
ブレイクアウトセッションでは招待講演講師毎のグループで双方向の議論をして頂けます。

＊招待講演とブレイクアウトセッション講師（1日目） 招待講演講師ごとのｸﾞﾙｰﾌﾟに分かれてオンライン討議。

- **中島 幸一氏 『AI スマートスピーカーの開発から観えてきた日本産業の課題』（iXOS 株式会社）**
- **針山 孝彦氏 『南極・アフリカ・北欧からの視点。生物の視覚～蟲瞰学：農薬不要へ～血液一滴で癌の検出まで』（浜松医科大学）**
- **八田 一氏 『エッグサイティングな卵の研究』（京都女子大学）**
- **田中 徹氏 『3DIC 技術を用いたバイオメディカル集積デバイスの開発』（東北大学）**
- **井川 拓人氏 『（仮題）GaO® デバイス社会実装に向けた取り組みについて』（株式会社 FLOSFIA）**
- **田窪 知章氏 『メモリ向けパッケージング技術』（キオクシア株式会社）**

＊基調講演＆特別講演（2日目）

- **黒田 忠広氏 『今、実装技術者に聴いていただくべき、半導体戦略（仮）』（東京大学 d.lab）**
- **奈良橋 弘久氏 『半導体パッケージ向け絶縁の開発動向（仮）』（味の素株式会社）**
- **黒田忠広氏(東京大学 d.lab センター長 先端システム技術研究組合理事長)を囲んでのマルチ Q＆A 対談**
  － 日本の半導体産業復活のために、いまエレクトロニクス実装技術者ができること －
  マルチ対談参加者：黒田忠広教授、高山氏(技術ライター・元日経 BP)、JIEP・エレクトロニクス実装技術者（調整中）

プログラム

１２/１３(月)

13:00 ～	開会の辞
13:10 ～	招待講演 第１部（講師講演 30 分×3 名）
15:00 ～	招待講演 第２部（講師講演 30 分×3 名）
17:00 ～	ブレイクアウトセッション （各班に分かれ招待講演講師と一緒にテーマを掘り下げ★）

★班、テーブル、部屋はバーチャルで設定されます。

１２/１４(火)

9:00 ～	基調講演 第１部（60 分）黒田氏（東京大学）
10:30 ～	ポスターセッション 第１部～第３部（25 分 x 3 部） （7 部屋を自由に往来 双方向のディスカッション★）
11:30 ～	交流タイム
13:00 ～	基調講演 第２部（60 分）奈良橋氏（味の素）
14:30 ～	ポスターセッション 第４部～第６部（25 分 x 3 部） （7 部屋を自由に往来 双方向のディスカッション★）
16:10 ～	特別対談（60 分） （黒田氏（東京大学）・高山氏（元日経 BP））・支部役員
17:10～	閉会の辞
17:20 頃	終了予定

プログラムの進行について

＊都合により予告なく内容が変更となる場合があります。ご了承ください。

リアルの実装フェスタ関西と同様に、タイムテーブルに沿ってプログラムを進行いたします。
参加者はインターネット環境が安定した場所からご参加ください。
ウェブ会議システム「Zoom」の使用を予定しております。

オンライン資料の公開について

参加申込をされた方を対象に 12/6～12/21 の期間、講演資料およびポスター発表のアブストラクト動画を公開予定です。
会期前の準備や、振り返りにお役立てください。

ポスターセッション

（敬称略）

カテゴリ	名前	テーマ	所属
カーエレクトロニクス・パワーエレクトロニクス	宮前 義範氏	機械学習を用いたパワートランジスタの信頼性予測手法	ローム株式会社
	五百旗頭 健吾氏	EMI抑制を目的としたRC/RLスナバ回路の最適設計法	岡山大学
接合・インターコネクト	青木 進平氏	ハイブリッドボンディング用高精度実装装置の開発	東レエンジニアリング株式会社
	松本 達朗氏	Sn-Bi系鉛フリーはんだ合金の接合特性	株式会社日本スペリア社　評価技術課
	池田 慎吾氏	プラズマ表面改質による銅とフッ素樹脂フィルムの直接接着	大阪産業技術研究所　電子材料研究部
基板・パッケージ・部品内蔵	宮崎 淳志氏	インクジェット技術で挑戦： 実装基板表面に機能を付与する(仮)	エレファンテック株式会社　AMC
	川井 若浩氏	電子回路を樹脂成形品に埋設する技術	三井化学株式会社
めっき	瀬戸 寛生氏	Co触媒を利用したボイドフリー最終表面処理プロセス	奥野製薬工業株式会社
	深田 和宏氏	高速タクト乾式めっき機の次世代回路形成プロセスへの適用	芝浦機械株式会社
	萩生田 太一氏	優れた耐食性と折り曲げ性を両立した高リンタイプ無電解Ni-Pめっき液の開発	ＪＸ金属商事株式会社
	深見 哲宏氏	陽極酸化法を用いた見えない画像形成	東海大学大学院工学研究科
	首長 寛信氏	ニシハラ理工のめっきについて(仮)	ニシハラ理工株式会社
ナノ材料・ナノペースト	吉川 太朗氏	ナノ粒子の基板上パターン配置技術	株式会社ダイセル
	間彦 智明氏	SiV蛍光ナノダイヤモンドの紹介	株式会社ダイセル
	大河内 拓雄氏	光電子顕微鏡：エレクトロニクス材料への展開	（公財）高輝度光科学研究センター
	稲田 佳信氏	銀ナノ粒子インク"Picosil®"	株式会社ダイセル
機能材料・複合材料	西村 雅翔氏	低誘電エポキシ樹脂の開発動向	三菱ケミカル株式会社
	香川 勝彦氏	パワーデバイスに適した熱伝導材「Zebro」	株式会社昭和丸筒
	岡村 和泉氏	ハイブリッド接合に適用可能な耐熱仮固定テープの開発	積水化学工業株式会社
	村井 真希氏	液晶性エポキシ樹脂を用いた高熱伝導アルミナコンポジットの調製	関西大学　化学生命工学部　化学・物質工学科
	伊藤 盛通氏	薄・柔を実現するミリ波帯域向け電波吸収体	（地独）大阪産業技術研究所　和泉センター
	森 三樹氏	AM技術とMIDを融合した三次元配線構造体	前　東京大学　生産技術研究所
	前川 茂俊氏	５Ｇ回路基板用ポリフェニレンスルフィド（ＰＰＳ）フィルムの開発	東レ株式会社　フィルム研究所
	泉 小波氏	印刷による平面型NMR用検出コイルの作製と評価	産業技術総合研究所
	小澤 雅徳氏	セルロースナノファイバーとポリピロールのハイブリッド導電性シート	東海大学大学院
フレキシブルエレクトロニクス	宇野 真由美氏	芯鞘構造を用いた荷重センシング諸撚糸の開発とスマートテキスタイルへの応用	(地独)大阪産業技術研究所
	中島 龍希氏	シール型可食性水分センサ	公立諏訪東京理科大学　工学部　機械電気工学科
MEMS・バイオ・医療	堀井 和由氏	高感度小型免疫システムの開発（仮）	シスメックス株式会社
	笹川 倖之介氏	汗中塩分量計測による熱中症予防計測システム実現に関する研究	公立諏訪東京理科大学大学院 工学・マネジメント研究科
	田中 秀典氏	AIを活用した健康プラットフォームサービスに向けたアプリ開発	長瀬産業株式会社
	岩崎 富生氏	マテリアルズ・インフォマティクスと分子シミュレーションによる生体分子の安定化技術	株式会社日立製作所　研究開発グループ
製造装置関係	Dennis Kim （金晟鉀）（代行：西田 秀行氏）	実装課題への挑戦、実装装置新方式によるソリューションの提案（仮題）	Dapara Tech（ダパラテック）株式会社
	西嶋 仁氏	マイクロブラストによる高アスペクト加工及び高精度加工技術の開発	新東工業株式会社
	瀧川 慎二氏	エレクトロニクス3Dプリンターによる3Dデバイスのフルアディティブ製造	株式会社FUJI　開発センター　技術部
環境・評価	清水 昭宏氏	VUV照射によるプラズマインジケータの変色特性	ウシオ電機株式会社
	寺崎 正氏	"見える"が拓くDX設計・予測・標準の革新	国立研究開発法人 産業技術総合研究所
新規融合分野・その他	金田 北洋氏	ポータブル液体センサーHyperTasteのご紹介	長瀬産業株式会社
	有本 太郎氏	エキシマランプを用いた高周波対応樹脂の表面改質	ウシオ電機株式会社
	駒﨑 友亮氏	湿度変化で発電する湿度変動電池	産業技術総合研究所　人間拡張研究センター

主催　エレクトロニクス実装学会　関西支部

【問い合わせ先】 E-mail: ws_kansai@　@以下のドメインは jiep.or.jp

協賛：日本ロボット工業会（JARA）、日本電子回路工業会（JPCA）、溶接学会マイクロ接合研究委員会、表面技術協会関西支部
応用物理学会関西支部、日本機械学会関西支部、日本材料学会関西支部、日本金属学会関西支部、高分子学会関西支部、電気学会関西支部
電子情報通信学会関西支部、日本接着学会関西支部、日本信頼性学会関西支部、スマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会
大阪府立大学ものづくりイノベーション研究所